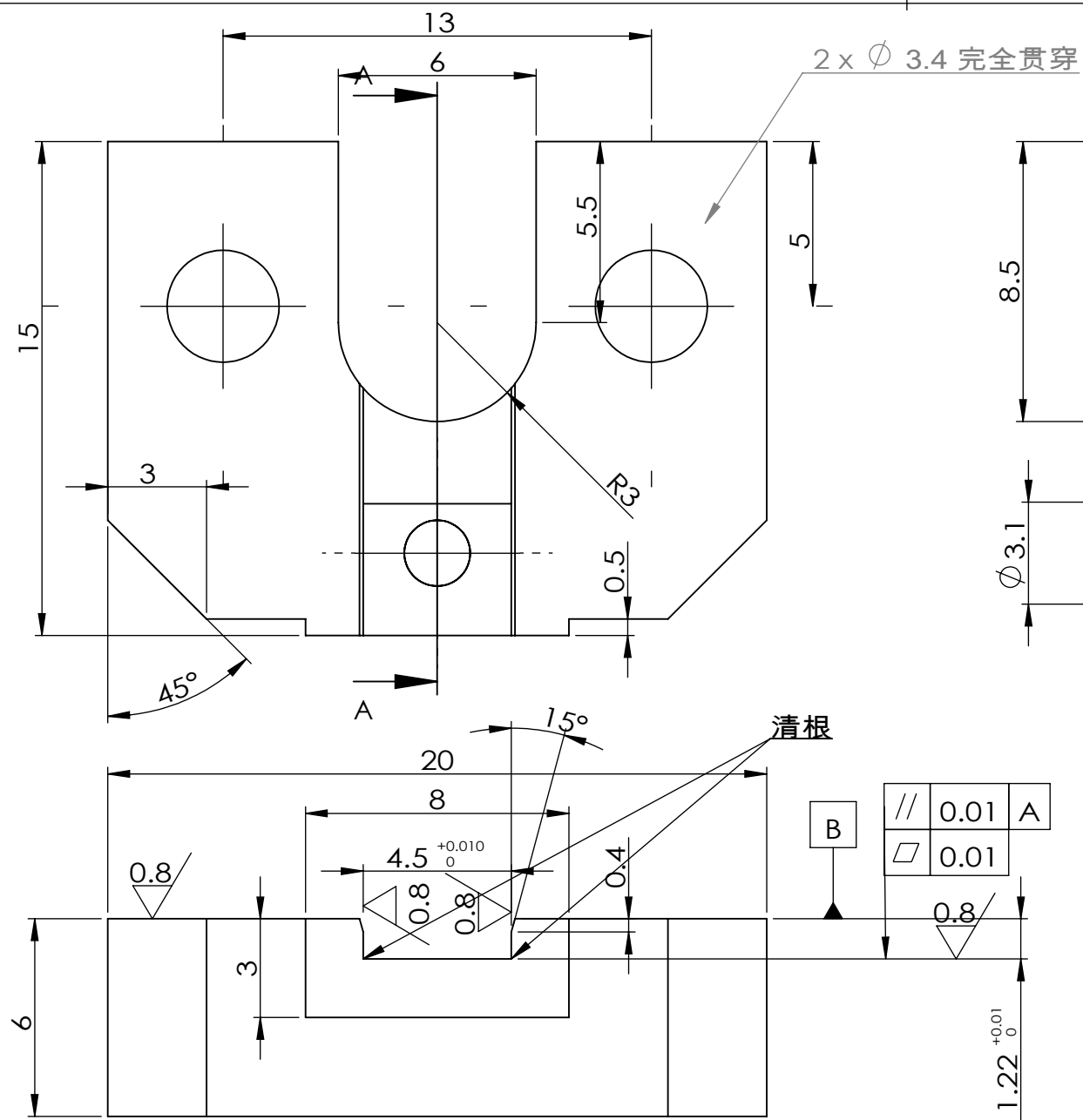
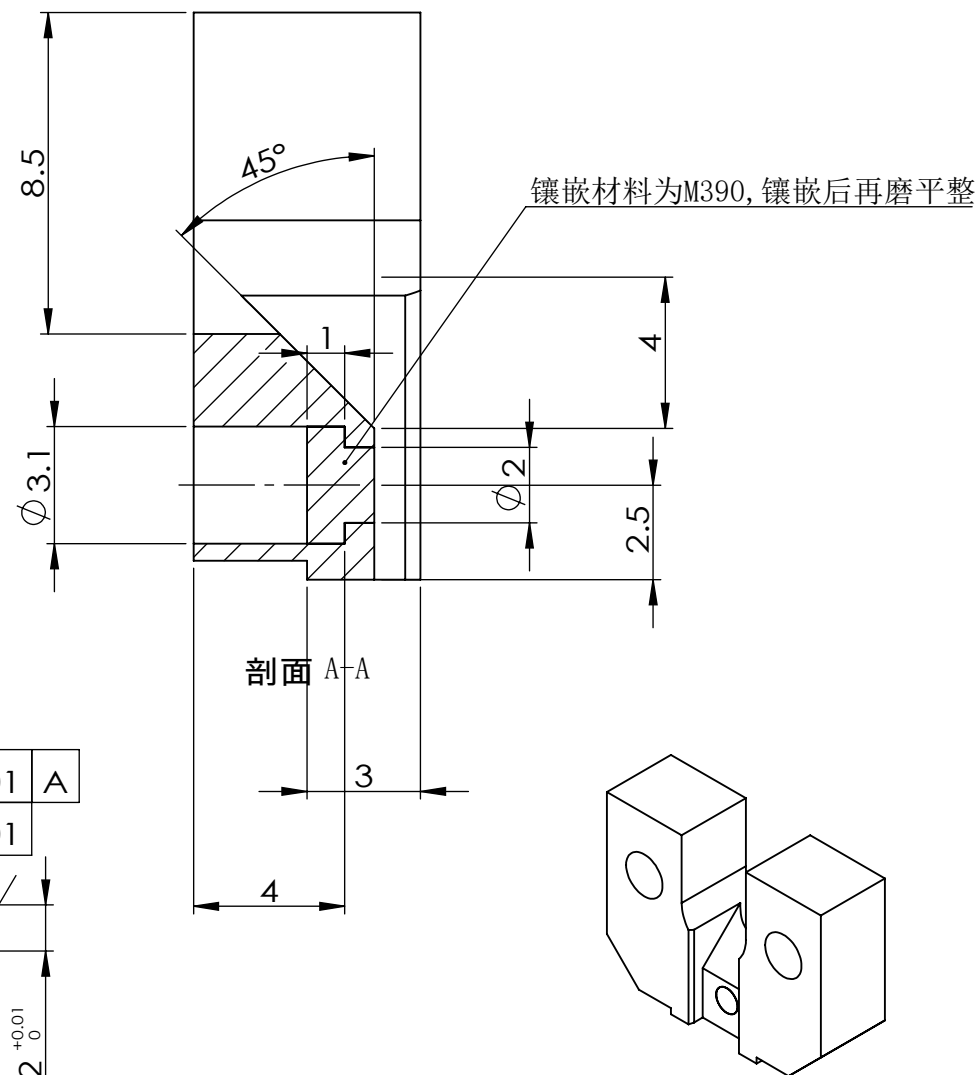




Other 3.2/



技术要求

1. 去除飞边、毛刺
2. 未注尺寸按3D加工, 未注倒角C=0.5, 未注圆角R=0.5
3. 未注尺寸公差按GB/T1804, M级
4. 未注形位公差按GB/T1184, K级
5. 处理后零件整体保持无磁, 不允许产生磁性。
6. 涂层无脱落、崩膜。

材质:	HPM75 无磁钢				图号:	MBC0-00-03-002
表面处理:	DLC镀层				零件名称:	磁座分离块
设计	日期	比例	单位	页码	图纸类型:	机加
SZM	2026/8/19	5:1	mm	1/1	精密等级:	A